

11月17日消息，昨日移动处理器大厂高通（Qualcomm）发布了骁龙8 Gen 2 旗舰5G移动平台，这款芯片并没有像骁龙8 Gen 1 那样交由三星代工，而是和骁龙8+ Gen 1 一样交给了台积电4nm工艺代工。这是否意味着高通的代工选择策略有了变化呢？

根据高通公布的数据显示，与上一代的骁龙8 Gen 1 相比，新一代骁龙8+ Gen 2 的CPU性能提升了35%、功耗降低了40%；GPU性能提升25%、功耗降低45%；AI性能提升4.35倍。虽然如此大幅性能的提升和功耗的降低，与全新的CPU/GPU/AI 内核架构升级有关，但是也离不开台积电4nm工艺的加持。这也是为什么高通骁龙 8 Gen 1 在遭遇三星4nm工艺良率不佳、发热等问题之后，转向台积电的一个重要原因。

不过，据韩国媒体 The ELEC 报导，高通公司高级副总裁 Don McGuire 指出，在考量各家晶圆代工厂的制程成熟度前提下，高通将持续与台积电之外，还将与三星、格芯等晶圆代工厂继续合作。